



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ

**ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКОЙ
И ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ**

ГОСТ 23770—79

Издание официальное

Цена 10 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ

Типовые технологические процессы химической
и гальванической металлизации

ГОСТ
23770-79*

Printed circuit boards Standard processes of chemical
and galvanic metallization

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июля
1979 г. № 2854 срок введения установлен

с 01.07.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 24.10.86
№ 3205 срок действия продлен

до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на процесс изготовления печатных плат позитивным комбинированным методом и многослойных печатных плат и устанавливает общие требования к типовому технологическому процессу химической и гальванической металлизации печатных плат: химическому меднению, предварительному и основному гальваническому меднению, осаждению сплава олово-свинец, осаждению благородных металлов, а также требованиям к процессу подготовки металлизированных отверстий многослойных печатных плат, изготавливаемых методом металлизации сквозных отверстий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Технологический процесс химической и гальванической металлизации печатных плат должен выполняться по схеме:

- подготовка поверхности;
- сенсibilизация и активация;
- химическое меднение;
- гальваническое меднение (предварительное);
- гальваническое меднение (основное);
- гальваническое осаждение сплава олово-свинец.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1987 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в октябре 1986 г. (ИУС 1--87)

© Издательство стандартов, 1988

После каждой операции производят промывку печатных плат водой.

Технологический процесс нанесения гальванических покрытий на разъемы печатных плат выполняют по схеме:

изготовление печатной платы позитивным комбинированным методом;

подготовка поверхности разъемов;

гальваническое нанесение подслоя и основного металла на разъемы (при использовании в качестве защитного металлического покрытия сплава олово-свинец необходимо сначала удалить его с разъемов; перед золочением и палладированием наносят подслои никеля или серебра).

1.2. Для приготовления и корректирования растворов сенсibilизации, активации, химического меднения и электролитов осаждения меди, сплава олово-свинец, благородных металлов должны применяться чистые и химически чистые вещества.

Материалы, применяемые при химической и гальванической металлизации печатных плат, приведены в рекомендуемом приложении 1.

1.3. Для приготовления растворов активирования и подтравливания диэлектрика должны применяться химически чистые кислоты.

1.4. Для приготовления и корректирования растворов, используемых при химической и гальванической металлизации печатных плат, а также в ваннах-сборниках должна использоваться дистиллированная или деионизированная вода.

1.5. Подготовка поверхности заготовок печатных плат должна производиться в соответствии с ГОСТ 23663—79, ОСТ 4.054.060—82 и рекомендуемыми приложениями 2А и 2Б.

1.6. Для повышения надежности межслойных соединений многослойных печатных плат перед операцией активации должна производиться гидроабразивная обработка поверхности стенок отверстий и подтравливание диэлектрика.

Гидроабразивная обработка должна производиться в соответствии с ГОСТ 23664—79. Подтравливание диэлектрика должно производиться в смеси серной и фтористоводородной кислот, взятых в соотношении $H_2SO_4 : HF = 5 : 1$. При приготовлении смеси кислот не допускается нагрев ее выше $60^\circ C$. Смесь кислот используют лишь через сутки после приготовления.

Допускается подтравливание диэлектрика производить сначала во фтористоводородной, а затем в серной кислоте или же в одной серной кислоте.

В одном литре раствора для подтравливания диэлектрика должно быть обработано не более 10000 отверстий.

1.3—1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. После операции подтравливания стенок отверстий заготовок многослойных печатных плат должна производиться промывка водой, обработка в щелочном растворе для нейтрализации и повторная промывка.

1.8. После операции подтравливания поверхность диэлектрика в отверстиях многослойных печатных плат должна быть без остатков продуктов травления. Кольцевые выступы контактных площадок не должны иметь остатков смолы.

1.9. Значение глубины подтравливания диэлектрика в отверстиях заготовок многослойных печатных плат должно быть в пределах от 0 до 30 мкм.

Последовательность операций подготовки поверхности отверстий перед химическим меднением приведена в рекомендуемом приложении 2.

1.10. Операции сенсibilизации, активации и химического меднения производят прокачиванием раствора через отверстия в заготовках печатных плат. Растворы сенсibilизации, активации и совмещенной активации должны быть защищены от воздействия прямых лучей света.

Рекомендации по приготовлению и корректировке растворов сенсibilизации и химического меднения приведены в рекомендуемом приложении 3.

1.11. При выполнении операции химического меднения заготовок печатных плат должны соблюдаться следующие условия:

значение водородного показателя (рН) раствора химического меднения должно быть в пределах 12,5—13,0;

плотность загрузки плат в ванну не должна превышать 2 дм²/л;

для поддержания постоянной скорости осаждения химической меди должна производиться корректировка и фильтрация рабочего раствора.

Последовательность технологических операций процесса химического меднения печатных плат приведена в рекомендуемом приложении 4.

1.10; 1.11. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.12. Слой меди, осажденной химическим способом на заготовках, должен быть сплошным, мелкокристаллическим, без отслоений; цвет покрытия — от светло-розового до темно-розового. Отенок не нормируется.

1.13. Продолжительность хранения заготовок перед предварительным гальваническим меднением должна быть минимальной, но не более двух суток. Платы перед хранением должны быть тщательно промыты и высушены.

1.14. Катодная плотность тока при предварительном гальваническом меднении должна быть не менее 0,5 А/дм². Толщина слоя

меди после предварительного гальванического меднения должна быть не менее 5 мкм.

1.15. При выполнении операций гальванической металлизации должны соблюдаться следующие условия:

гальванические процессы должны проводиться с использованием тока постоянной полярности;

допускается серебрение и меднение выполнять с реверсированием тока;

заготовки плат в ванны гальванической металлизации должны находиться под током, при этом допускается отклонение от рабочей плотности тока $\pm 10\%$;

при основном меднении отношение анодной поверхности к катодной должно быть не менее 2:1, при этом поверхность анода, обращенная к стенке ванны, принимается за половину.

Методы приготовления и корректировки электролитов приведены в ГОСТ 9.305—84.

Последовательность операций технологического процесса химического меднения, предварительного и основного гальванического меднения, гальванического осаждения сплава олово-свинец приведена в рекомендуемых приложениях 5 и 6.

1.16. Толщина меди в отверстиях, находящихся в центре печатной платы, должна быть не менее 25 мкм, сплава олово-свинец на поверхности заготовки — не более 10—15 мкм. Содержание олова в сплаве должно быть $(61 \pm 3)\%$, свинца — $(39 \pm 3)\%$.

1.17. При покрытии заготовок печатных плат благородными металлами толщина слоя должна соответствовать рабочему чертежу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям ГОСТ 9.303—84.

1.13—1.17. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.18. Покрытие разъемов печатных плат благородными металлами должно проводиться после операции травления меди с пробельных мест.

1.19. Если в качестве защитного покрытия рисунка схемы использовался сплав олово-свинец, то перед нанесением благородного металла на разъем сплав должен быть удален с разъемов.

Растворы для удаления сплава олово-свинец с разъемов приведены в рекомендуемом приложении 7.

1.20. При золочении и палладировании разъемов печатных плат предварительно наносят подслоем серебра или никеля.

Рекомендации по нанесению подслоя серебра и никеля приведены в рекомендуемых приложениях 8 и 9.

Рекомендации по выполнению операций палладирования и золочения разъемов печатных плат приведены в рекомендуемых приложениях 10 и 11.

1.21. Внешний вид гальванических покрытий, наносимых на заготовки печатных плат, должен соответствовать ГОСТ 9.301—86.

1.22. Основные неполадки при химической и гальванической металлизации и способы их устранения приведены в рекомендуемом приложении 12.

1.23. Требования к оборудованию для химической и гальванической металлизации печатных плат приведены в рекомендуемом приложении 13.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Производственные помещения должны удовлетворять требованиям санитарных норм проектирования промышленных предприятий СН 245—71, утвержденных Госстроем СССР.

2.2. При хранении и работе с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими веществами (ГЖ) необходимо соблюдение требований ГОСТ 12.1.004—85, ГОСТ 12.1.010—76 и «Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий», утвержденных ГУПО МВД СССР.

2.3. На участке химико-гальванической металлизации должны быть предусмотрены:

средства малой механизации для разлива кислот и щелочей на малые объемы, централизованная подача рабочих растворов в ванны, слив и нейтрализация отработанных растворов — при крупносерийном производстве;

защитные очки, резиновые кислотощелочестойкие перчатки по ГОСТ 20010—74, резиновые сапоги по ГОСТ 5375—79, рабочие фартуки по ГОСТ 12.4.029—76 — при приготовлении растворов и загрузке оборудования.

2.4. Для предупреждения воздействия вредных производственных факторов на работающих в области изготовления печатных плат следует предусмотреть средства индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим машиностроительных и межотраслевых производств», утвержденными Постановлением Государственного комитета по труду и социальным вопросам.

2.5. На всех единицах оборудования, где происходит выделение вредных веществ, должна быть предусмотрена местная вытяжная вентиляция.

2.6. Рабочие помещения должны обеспечиваться общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена должна обеспечивать содержание вредных паров в воздухе не более предельно допустимой концентрации, установленной ГОСТ

12.1.005—76. Приточная вентиляция должна компенсировать воздух, удаляемый общей и местной вытяжной вентиляцией.

2.7. Систематически контролировать состояние воздушной среды помещений по графикам, согласованным с санитарной эпидемиологической станцией.

2.8. Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха должны соответствовать СНиП II 33—75.

2.9. Требования к температуре, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать ГОСТ 12.1.005—76.

2.10. Для предупреждения поражения электрическим током при химической и гальванической металлизации печатных плат должны выполняться требования ГОСТ 12.2.007—75, «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Степень обезжиривания поверхности заготовок определяют по смачиваемости.

Заготовку выдерживают после промывки водой под углом 60°. Если пленка воды сохраняется сплошной в течение 1 мин, подготовку считают удовлетворительной.

3.2. Целостность фольги, механические включения, наличие окислов проверяют визуально.

3.3. После операции подтравливания у каждой платы просматривают по 10—15 отверстий.

3.4. Значение глубины подтравливания диэлектрика в отверстиях многослойных печатных плат контролируют после операции гальванического меднения. Контроль производят по металлографическим шлифам отверстий, просверленных на технологическом поле платы.

3.5. Начало процесса химического осаждения меди контролируют визуально по выделению пузырьков водорода.

3.6. Качество химически осажденной меди, гальванических покрытий медью, сплавом олово-свинец и драгоценными металлами контролируют визуально, а в необходимых случаях применяют оптические средства контроля с увеличением 5—10×.

Качество металлизации контролируют на 3—5% заготовках от партии, но не менее чем на трех заготовках.

3.7. Проверку толщины слоя металла в отверстиях проводят металлографическим методом по ГОСТ 9.302—79 на отверстиях гест-купонов или любого участка серийно изготовленной платы.

Проверке подвергают 4—6 отверстий. Допускается проводить контроль толщины металлизации в отверстиях средствами электрического контроля.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.8. Замер толщины гальванически осажденного покрытия на проводниках производят по ГОСТ 9.302—79.

3.9. Общую щелочность раствора определяют титрованием.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Номер стандарта или ТУ
Аммиак водный	ГОСТ 3760—79
Аммоний надсерноокислый	ГОСТ 20478—75
Ангидрид хромовый технический	ГОСТ 2548—77
Аноды золотые	ГОСТ 25475—82
Аноды медные	ГОСТ 767—70
Аноды медные с фосфором МФ—0, МФ—1	ТУ 48—21—5045—80
Аноды никелевые НПА 1, НПА 2	ГОСТ 2132—75
Аноды серебряные марки Сr999	ГОСТ 25477—82
Аноды оловянные марок 01	ГОСТ 860—75
Аноды свинцовые марок С1, С2	ГОСТ 3778—77
Ацетон	ГОСТ 2603—79
Блескообразователь Лимеда ПОС-1	РСТ Лит ССР 1013—85
Бумага фильтровальная лабораторная	ГОСТ 12026—76
Бязь хлопчатобумажная	ГОСТ 11680—76
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709—72
Гидрохинон	ГОСТ 19627—74
Диметилглиоксим	ГОСТ 5828—77
Диэтилдитиокарбамат (ДДК)	ГОСТ 8864—71
Диметилформамид	ГОСТ 20289—74
Добавка ДС—Na	ТУ АУЭО 028007 ПМ
Изоляционная лента ПВХ	ГОСТ 16214—86
Калий дициано-(I)-аурат	ГОСТ 20573—75
Калий железистосинеродистый	ГОСТ 4206—75
Калий-натрий виннокислый	ГОСТ 5845—79
Калий роданистый	ГОСТ 4139—75
Калий углекислый	ГОСТ 4221—76
Кислота борная	ГОСТ 9656—75
Кислота борфтористоводородная	ТУ 6 09—2577—77
Кислота лимонная	ГОСТ 3652—69
Кислота серная	ГОСТ 4204—77
Кислота серная техническая	ГОСТ 2184—77
Кислота соляная	ГОСТ 3118—77
Кислота соляная синтетическая техническая	ГОСТ 857—78
Кислота фтористоводородная	ГОСТ 2567—73
Клей мездровый	ГОСТ 3252—80
Клей ХВК—2А	ТУ 6 10—463—75
Кобальт серноокислый	ГОСТ 4462—78
Лак ХС	ГОСТ 9355—81
Магний серноокислый	ГОСТ 4523—77
Медь углекислая основная	ГОСТ 8927—79
Медь серноокислая ч, хч	ГОСТ 4165—78
Микропорошок М-40	ГОСТ 3647—80
Натр едкий улучшенный	ГОСТ 11078—78
Натр едкий технический	ГОСТ 2263—79

Наименование	Номер стандарта или ТУ
Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия)	ГОСТ 244—76
Натрий углекислый кристаллический	ГОСТ 84—76
Натрий фосфорноватистокислый (гипосульфит натрия)	ГОСТ 200—76
Никель сернокислый	ГОСТ 4465—74
Никель двухлористый	ГОСТ 4038—79
Олово двухлористое очищенное	ГОСТ 4780—78
Олово (II) борфтористое (30% раствор)	ТУ 6—09 - 2683--77
Очки герметичные	ГОСТ 12 4 013—85
Палладий двухлористый	ТУ 6—09—2025--72
Перекись водорода	ГОСТ 177—77
Полировальная известь	ТУ 6 18—148—78
Пептон сухой ферментагивный	ГОСТ 13805- 76
Порошок абразивный	ГОСТ 2424—83
Порошок абразивный зернистостью № 40—II	ГОСТ 3647—80
Роданин	ГОСТ 10730—82
Синтанол АЛМ-10	ТУ 6—14—19—472—83
Синтанол ДС-10	ТУ 6--14—577--77
Свинец углекислый средний	ГОСТ 10275—74
Свинец окись	ГОСТ 9199—77
Свинец (II) борфтористый раствор	ТУ 6 -09-- 4409--77
Серебро азотнокислосое	ГОСТ 1277—75
Спирт бутиловый нормальный	ГОСТ 6006—78
Спирт этиловый ректифицированный технический	ГОСТ 18300—87
Сукно шинельное	ГОСТ 6621- -72
Ткань фильтровальная капроновая	ГОСТ 18436—73
Тиомочевина	ГОСТ 6344--73
Трилон Б (соль динатриевая эгилендиамин- <i>N</i> , <i>N'</i> , <i>N'</i> -тетрауксусной кислоты 2-водная)	ГОСТ 10652- 73
Тринатрийфосфат	ГОСТ 201—76
Уголь активный древесный дробленный	ГОСТ 6217—74
Удалитель Лимеды УПОС	ТУ 88 Лит ССР—84
Формалин технический	ГОСТ 1625-- 75
Шкурка шлифовальная водостойкая на бумаж- ной основе № 6, № 7	ГОСТ 10054—82
Шлифовальный порошок № 11, № 12	ГОСТ 3647 -80

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ МНОГОСЛОЙНЫХ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ МЕТОДОМ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ПЕРЕД ХИМИЧЕСКИМ МЕДНЕНИЕМ**

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Гидроабразивная обработка отверстий				
Подтравливание диэлектрика в отверстиях	Состав 1: серная кислота (плотность 1,84)		35—40	1—1,5
	Состав 2: серная кислота (плотность 1,84) фтористоводородная кислота (30—40%)	5 объемов 1 объем	18—25	0,7—0,8
Промывка проточной водопроводной водой				
Травление стеклоткани в отверстиях	Фтористоводородная кислота (30—40%)		18—25	0,2—0,4
Промывка проточной горячей водой			45—55	2—3
Сушка			35—40	10—20
Контроль				

Продолжение

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Ультразвуковая очистка отверстий	Дистиллированная или деонизированная вода		18—25	2—4
Сушка			40—50	15—20
Контроль				

Примечания:

1. Гидроабразивная подготовка — по ГОСТ 23664—79.
2. При некачественной очистке отверстий допускается повторная гидроабразивная обработка.

Приложения 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
ПОЛУАДДИТИВНЫМ СПОСОБОМ**

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Подготовка поверхности адгезива				
Обезжиривание	Тринатрийфосфат	30	40—60	2—5
	Сода кальцинированная	30		
	Синтетическое моющее средство	5		
Промывка горячей проточной водой	—	—	45—55	2—3
Промывка холодной проточной водой	—	—	15—25	2—3
Обработка для набухания	Диметилформамид	—	18—25	5—7
Промывка холодной проточной водой	—	—	15—25	2—3
Травление	Ангидрид хромовый	800—810	50—60	3—10
	Кислота серная (пл. 1,84)	250—260		
	Вода дистиллированная	800		
Промывка горячей проточной водой	—	—	45—55	5—7

Продолжение

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание г/л	Температура °С	Время, мин
Промывка холодной проточной водой	—	—	15—25	2—3
Нейтрализация	Состав 1 натрий кислый сернисто-кислый кислота серная (пл 1,84)	10—15 15—20	18—25	1—2
	Состав 2: натрий гидроокись вода дистиллированная	30—60 до 1 л	18—25	1—2
Промывка холодной проточной водой	—	—	15—25	2—3
Нейтрализация	Кислота соляная (пл 1,19)	50	18—25	1—2
Промывка холодной проточной водой	—	—	15—25	2—3
Промывка проточной деионизированной водой	—	—	18—25	1—2
Активация	Палладий двухлористый	0,5—0,8	18—25	4—5
	Кислота соляная	0,6—1,0		

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
НА МАТЕРИАЛЕ ТИПА СТПА-5**

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание г/л	Температура °С	Время мин
Обезжиривание по поверхности заготовок	Тринарийфосфат	25 -35	45 60	2
	Сода кальцинированная	25 --35		
	Синтетическое моющее средство	3 5		
Промывка горячей проточной водой	—		50—60	1- 2
Промывка холодной проточной водой	—	--	15-- 25	0,5 1,0
Активация химическая	Кислота серная (пл 1,84)	50 - 100	18 - 25	0,2-- 0,3
Промывка холодной проточной водой	—	—	не менее 15	0,5 -1,0
Подтравливание	Аммоний надсернистый	200 250	18 25	до 0,5
	Кислота серная (пл 1,84)	10 20		
Промывка холодной водой	—	—	15- 25	2 3
Активация химическая	Кислота соляная (пл 1,19)	50- 100	18 - 25	0,03 0,05
Промывка холодной проточной водой	—	--	18 -25	1- 2
Сушка	--	--	30 40	1 3

Приложения 2А, 2Б (Введены дополнительно, Изм. № 1).

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ, АКТИВАЦИИ
И ХИМИЧЕСКОГО МЕДНЕНИЯ. РЕГЕНЕРАЦИЯ ДВУХЛОРИСТОГО
ПАЛЛАДИЯ**

Приготовление раствора сенсibilизации

С о с т а в

двухлористое олово 20—25 г/л,
соляная кислота 13—17 г/л,
металлическое олово 1—2 г/л

Навеску двухлористого олова вводят в дистиллированную воду, подкисленную необходимым количеством соляной кислоты, и доливают раствор до необходимого объема, вводят металлическое олово

Раствор используют до уменьшения содержания двухлористого олова до 8—10 г/л, после чего заменяют на новый

II Приготовление и корректирование раствора совмещенного активирования

С о с т а в

палладий двухлористый 0,8—1,0 г/л,
олово двухлористое 40—45 г/л,
кислота соляная 100—120 г/л,
калий хлористый 140—150 г/л

Двухлористый палладий растворяют в 6 мл соляной кислоты при температуре 60—70°С. Раствор охлаждают, разбавляют водой до 20 мл

Двухлористое олово растворяют в 20 мл соляной кислоты при температуре 30—40°С. Раствор охлаждают, разбавляют водой до 50 мл

Раствор двухлористого олова медленно вливают в раствор двухлористого палладия и выдерживают при температуре от 90°С до 100°С в течение 10—15 мин. В полученный раствор добавляют 900 мл раствора, содержащего остальную кислоту и хлористый калий, и доливают водой до 1 л

Раствор корректируют по данным химического анализа на содержание двухлористого олова, двухлористого палладия и соляной кислоты

При уменьшении содержания двухлористого олова до 10—12 г/л раствор корректируют введением кристаллического двухлористого олова, затем прогревают при температуре 60—70°С в течение 10—20 мин

При уменьшении содержания двухлористого палладия до 0,4 г/л раствор корректируют введением концентрированного раствора двухлористого палладия в соляной кислоте

При уменьшении содержания соляной кислоты до 80 мл/л раствор корректируют добавлением соляной кислоты

В случае образования осадка или ослабления активирующей силы раствор корректируют по всем компонентам и прогревают при температуре 60—70°С в течение 10—20 мин. Не следует производить фильтрование

III Приготовление раствора химического меднения на основе сегнетовой соли

С о с т а в

сернокислая медь 10—15 г/л,
калий натрия виннокислый (сегнетова соль) 50—60 г/л,
натрий гидрат окиси 10—15 г/л,

никель хлористый 2—4 г/л,
серноватистоокислый натрий 0,002 г/л,
формалин (33%) 10—20 мл/л;
натрий углекислый 5—7 г/л

Растворяют расчетное количество сернокислой меди и двухлористого никеля в половине необходимого объема воды. В другой половине растворяют гидрат окиси натрия, сегнетову соль и углекислый натрий. Вливают порциями при перемешивании раствор меди в щелочной раствор сегнетовой соли. Добавляют расчетное количество тиосульфата натрия в виде раствора 0,001 г/л. Электролит отфильтровывают, доливают водой до необходимого объема и проверяют значение рН раствора, которое должно быть 12,6—12,8.

IV Приготовление растворов химического меднения на основе трилона Б

Состав 1

сернокислая медь 13—15 г/л;
трилон Б 25—30 г/л,
натр едкий 13—15 г/л,
роданистый калий 0,01—0,04 г/л,
формалин (33%) 15—20 мл/л

В отдельных объемах воды растворяют сернокислую медь с трилоном Б и едкий натр. При интенсивном перемешивании вливают раствор едкого натра в раствор с сернокислой медью и трилоном Б. Доводят уровень раствора дистиллированной водой до заданного.

В приготовленный раствор сернокислой меди, трилона Б и едкого натра вводят раствор роданистого калия. Формалин вводят перед началом работы. Готовый раствор отфильтровывают и проверяют значение рН раствора, которое должно быть 12,6—12,8.

Состав 2:

медь сернокислая 25—35 г/л;
трилон Б 80—90 г/л;
натрий гидрат окиси 30—40 г/л;
натрий углекислый 20—30 г/л;
роданин 0,003—0,005 г/л,
калий железосинеродистый 0,10—0,15 г/л,
формалин 20—25 г/л

Растворяют отдельно расчетное количество сернокислой меди и железосинеродистого калия. В отдельной емкости растворяют гидрат окиси натрия, углекислый натрий и вводят в раствор расчетное количество сухого трилона Б. Готовят раствор стабилизатора, растворив 3,0 г роданина в дистиллированной воде, в которую вводят две-три капли концентрированного раствора едкого натра и доливают до 1 л. Раствор сернокислой меди вливают в раствор едкого натра с трилоном Б, тщательно перемешивают и добавляют железосинеродистый калий с роданином. Раствор отфильтровывают, доливают до необходимого объема и проверяют значение рН раствора, которое должно быть равно 12,6—12,8. Формалин добавляют в раствор за 10—15 мин до начала работы.

V. Приготовление раствора активации

Состав:

палладий двухлористый 0,8—1,0 г/л;
соляная кислота 1—2 мл/л,
вода до 1 л

Навеску измельченного двухлористого палладия растворяют в дистиллированной воде, подкисляют соляной кислотой, нагретой до температуры 60°C. Раствор охлаждают до комнатной температуры и доливают водой до нужного объема.

VI Регенерация двухлористого палладия

1 Регенерация палладия из сборников

Промывные воды из сборников палладия собирают в отдельную ванну. Раствор подкисляют концентрированной соляной кислотой до полного растворения осадка. В ванну на 24 ч опускают две пластины-электроды из цинка и стали 12Х12Н9Т, расположенные по противоположным бортам ванны и замыкают с помощью медной проволоки. Раствор периодически перемешивают. Палладий выпадает в виде черного осадка. Фильтрат проверяют на полноту осаждения реакцией диметилглиоксима (бесцветный раствор указывает на полноту осаждения). Фильтрат, не содержащий ионов палладия, сливают в канализацию. Осадок палладия скальпелем снимают с пластин, высушивают, упаривают досуха при температуре 100—120°C, растирают в фарфоровой ступке, просеивают.

2 Регенерация палладия из отработанного совмещенного раствора активации

В раствор, содержащий палладий, добавляют соляную кислоту, если ее концентрация в растворе менее 200 г/л, опускают цинковые стержни и выдерживают их до полного обесцвечивания раствора (плотность загрузки 2—3 дм²/л). Раствор отделяют от осадка декантацией. Осадок заливают соляной кислотой в объемном соотношении 1:10, тщательно перемешивают и выдерживают 1—2 ч, периодически перемешивая. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:1 и отфильтровывают через двойной бумажный фильтр. Осадок на фильтре промывают разбавленной соляной кислотой (1:1) до прекращения вскипания и получения мелкодисперсного осадка, затем — дистиллированной водой в течение 5 мин. Промытый осадок растворяют в минимальном количестве разбавленной соляной кислотой с добавкой перекиси водорода в объемном соотношении 15:1 и нагревают раствор до разложения перекиси.

Доводят аммиаком рН раствора до 5. Добавляют в этот раствор 1%-ный спиртовой раствор диметилглиоксима, затем нагревают, образуется осадок диметилглиоксимата палладия желтого цвета. Отфильтровывают осадок через двойной бумажный фильтр. Фильтрат проверяют на полноту осаждения реакцией с диметилглиоксимом (бесцветный раствор указывает на полноту осаждения). Фильтрат, не содержащий ионов палладия, сливают в канализацию. Прокаливают осадок диметилглиоксимата палладия при температуре 850°C.

МЕДНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Активация химическая	Соляная кислота	50—100	18—25	0,3—0,5
Сенсибилизация	Двухлористое олово	20—25	18—25	2—5
	Соляная кислота	13—17		
	Металлическое олово	1—2		
Промывка проточной водопроводной водой				2—3
Промывка дистиллированной водой			18—25	1—2
Активация	Состав 1: двухлористый палладий соляная кислота	0,8—1,0 1—2 мл/л	18—25	2—3
	Состав 2: двухлористый палладий двухлористое олово соляная кислота хлористый калий	0,8—1,0 40—45 100—120 140—150		
	Состав 3: двухлористый палладий двухлористое олово хлористый натрий бисульфат натрия соляная кислота	0,4—0,5 10—14 200 70 50 мл/л		
Промывка в сборнике I			18—25	0,5—1,0
Промывка в сборнике II			18—25	0,5—1,0

Продолжение

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Промывка в сборнике III			18—25	0,5—1,0
Обработка в растворе ускорителя	Соляная кислота	50—100	18—25	1—2
Промывка проточной водопроводной водой Меднение химическое	Состав 1: сернистая медь виннокислый калий-натрий едкий натр двухлористый никель серноватистокислый натрий формалин (33%-ный)	10—15	18—25	1—2
		50—60	18—25	20—30
		10—15		
	2—4			
	0,001			
	10—20 мл/л			
	Состав 2: сернистая медь виннокислый калий-натрий едкий натр углекислый натрий хлористый никель серноватистокислый натрий этиловый спирт формалин (33%-ный)	30—35	18—25	15—20
	170—190			
	40—60			
	30—35			
	4—6			
	0,001—0,003			
	10 мл/л			
	20—30 мл/л			
	Состав 3: сернистая медь трилон Б натрий гидрат окиси углекислый натрий роданин	25—35	18—25	15—20
	80—90			
	40—60			
	20—30			
	0,003—0,005			

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание г/л	Температура, °С	Время мин
	железосинеродистый калий формалин (33%-ный)	0,10—0,15 20—30 мл/л		
	Состав 4: сернокислая медь трилон Б едкий натр роданистый калий формалин (33%-ный)	13—15 25—30 13—15 0,01—0,04 15—20 мл/л	18—25	15—20
Промывка в сборнике				0,5—1,0
Промывка проточной водопроводкой водой				3—5
Сушка			30—40	3—5
Контроль				

Примечания

1 Раствор активации используют при изготовлении плат на нефольгированном диэлектрике Раствор совмещенной активации используют при изготовлении двухсторонних и многослойных плат на фольгированных диэлектриках

2 В совмещенном растворе активации состава 2 допускают применение хлористого натрия вместо хлористого калия

3 При активации в составах 2 и 3 сенсибилизацию не производят Составы растворов активации 2 и 3 применяют при изготовлении многослойных печатных плат методом металлизации сквозных отверстий

4 Допускается применение в растворах химического меднения других стабилизаторов

5 Допускается в растворах химического меднения составов 1 и 2 вместо калия—натрия виннокислого применять калий—натрий виноградно-кислый Для улучшения внешнего вида осадков химической меди рекомендуется применять железосинеродистый калий (10% ный раствор, 2—3 мл/л), формалин вводят на 50% меньше указанного в рецептуре

6 Допускается использование раствора химического меднения состава
сульфат меди 25 г/л;
трилон Б 50 г/л;
формалин (40%-ный) 20—40 мл/л,

добавок диэтилдитиокарбоната натрия (5—15 мг/л), фенилтиогидантоиновой кислоты (5—15 мг/л), этилдиамина (50—100 мл/л) или феррицианида калия (30—50 мг/л).

7. Допускается использование раствора химического меднения состава:
- медь сернокислая 20—25 г/л;
 - калий-натрий виннокислый (сегнетова соль) 60—80 г/л;
 - натрий гидрат окиси 25—30 г/л;
 - формалин (33%) 15—18 мл/л;
 - диэтилдитиокарбамат (ДДК) 50 мг/л.

Рабочая температура — (40 ± 2) °С, рН 12,5—13,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ МЕДНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Обезжиривание	Серная кислота (10%)	55	18—25	2—3
	Моющее средство «Синтанол» или ОС—20	3—5		
Промывка горячей проточной водой			45—55	2—3
Промывка проточной водопроводной водой				2—3
Подтравливание	Надсернокислый аммоний Серная кислота	200 250 5- 7	18—25	0,5—1,0
Промывка проточной водопроводной водой				2—3
Активация химическая	Серная кислота	90 100	18 25	0,08—0,16

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Промывка проточной водопроводной водой				1—2
Меднение электролитическое	Состав 1: сернистая медь серная кислота этиловый спирт	220—230 50—60 10 мл/л	18—25	
	Состав 2: борфтористоводородная медь борфтористоводородная кислота (свободная) борная кислота (свободная)	230—250 5—15 15—40	13—25	
	Состав 3: кремнефтористоводородная медь кремнефтористоводородная кислота (свободная)	250—300 10—15	18—25	
	Состав 4: сернистая медь серная кислота хлористый натрий блескообразующая добавка ЛТИ	220—230 50—60 0,03—0,06 1—5 мл/л		
Промывка в сборнике			18—25	1—2
Промывка проточной водопроводной водой				1—2
Сушка			50—60	1—2
Контроль				

Примечания:

1. Предварительное и основное меднение производят в одних и тех же электролитах.

2. Скорость осаждения меди из сернокислого электролита при плотности тока 3 А/дм^2 — 1 мкм за 1,6 мин.

3. Скорость осаждения меди из борфтористоводородного электролита при плотности тока 4 А/дм^2 — 1 мкм за 1,2 мин.

4. Скорость осаждения меди из кремнефтористоводородного электролита при плотности тока 5 А/дм^2 — 1 мкм за 1 мин.

5. Допускается в электролит меднения состава 3 введение бензотриазола в количестве 0,002—0,008 г/л. Скорость осаждения меди при Дк-12 А/дм^2 составляет 150 мкм/ч.

6. Подтравливание в растворе надсернокислого аммония проводят только после предварительного гальванического меднения.

7. Для очистки активного угля его промывают проточной водой, подсушивают фильтровальной бумагой, кипятят в 15%-ном растворе серной кислоты в течение 0,5 ч, промывают проточной водой, отжигают в сушильном шкафу при температуре 300—350°C в течение 1,5—2 ч, охлаждают, не вынимая из шкафа, и затем хранят в закрытой емкости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СПЛАВА ОЛОВО-СВИНЕЦ
НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы		
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин	Плотность тока, А/дм^2
Активация химическая	Борфтористоводородная кислота	50—100	18—25	0,2—0,5	
Промывка	—	—	—	1—2	
Электролитическое осаждение сплава олово-свинец	Состав 1: олово (II) борфтористое (в пересчете на металл) свинец (II) борфтористый (в пересчете на металл) борфтористоводородная кислота (свободная)	50—60	18—25		0,8—1,0
		25—40			
		40—75			

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы		
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин	Плотность тока, А/дм ²
Электролитическое осаждение сплава олово-свинец	борная кислота (свободная) мездровый клей или пептон гидрохинон	25—35 3—5 0,8—1,0	18—25		0,8—1,0
	Состав 2: олово (II) борфтористое (в пересчете на металл) свинец (II) борфтористый (в пересчете на металл) кислота борфтористоводородная (свободная) кислота борная (свободная) пептон гидрохинон	12—15 7—9 250—280 20—30 4—6 0,8—1,0			1,5 2,0
	Состав 3: олово (II) борфтористое (в пересчете на металл) свинец (II) борфтористый (в пересчете на металл) кислота борфтористоводородная (свободная) синтанол ДС-10 (10% раствор) добавка ДС - Na (10% раствор)	26—30 15—18 80—90 60 мл/л 5 мл/л	15—25		2,5—3,0
	Состав 4: олово (II) борфтористое (в пересчете на металл) свинец (II) борфтористый (в пересчете на металл) борфтористоводородная кислота (свободная) борная кислота (свободная)	12—18 5—9 180—200 10—30			

Продолжение

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы		
	Наименование	Содержание г/л	Температура, °С	Время мин	Плотность тока, А/дм ²
Электролитическое осаждение сплава олово-свинец	синтанол ДС-10 или АЛМ-10 блескообразователь Лимеда ПОС-1	8 0,6			
Промывка в сборнике				1—2	
Промывка в горячей проточной воде			50—70	1—2	
Сушка			50—60	5—10	
Контроль					

Примечания

- 1 Скорость осаждения при плотности тока 0,8 А/дм² — 1 мкм за 2,5 мин
- 2 Аноды — припой ПОС—61 П по ГОСТ 21930—76 или сплавные, содержащие (61±3) % олова и (39±3) % свинца
- 3 Скорость осаждения сплава из электролита состава 1 при плотности тока 0,8 А/дм² — 1 мкм за 2,5 мин
- 4 Скорость осаждения сплава из электролита состава 4 при плотности тока 1 А/дм² — 0,5 мкм/мин

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендуемое

**РАСТВОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СПЛАВА ОЛОВО-СВИНЕЦ
С РАЗЪЕМОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ**

Состав 1:

борфтористоводородная кислота 330 мл;
пергидроль 70 мл/л;
вода до 1 л.

Температура раствора 18—25°C, продолжительность обработки 3—5 мин

Состав 2

азотная кислота 400—500 мл/л,

борфтористоводородная медь 5—10 г/л,

препарат ОС—20 2—5 г/л

Температура раствора 18—25°C, скорость удаления сплава 3—4 мкм/мин

Поверхность над разъемами должна быть защищена липкой лентой

Состав 3

борфтористоводородная кислота — 150 мл/л,

удалитель Лимеда УПОС — 100 г/л

Температура 18—25°C, скорость удаления от 2 мкм/мин в перемешиваемом растворе, до 5 мкм/мин при перемешивании

Допускается увеличение температуры раствора до 40°C

Приложения 3—7 (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Рекомендуемое

НИКЕЛИРОВАНИЕ РАЗЪЕМНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание г/л	Температура °С	Время мин
Подготовка поверхности				
Никелирование	Сернокислый никель	140—200	18—25	
	Сернокислый магний	30—50		
	Сернокислый натрий	50—70		
	Борная кислота	25—30		
	Хлористый натрий	3—5		
Промывка в сборнике				1—2
Промывка проточной водопроводной водой				2—3
Сушка			30—40	3—5
Контроль				

Примечание Скорость осаждения при плотности тока 0,8 А/дм² — 1 мкм за 6,5 мин, при плотности тока 1 А/дм² — 1 мкм за 4,5 мин

СЕРЕБРЕНИЕ РАЗЪЕМОМ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Зачистка поверхности разъемов	Шлифшкурка № 6 или № 7			
Промывка проточной воды				0,25—0,3
Сушка			35—40	20
Покрытие лаком поверхности ниже печатных разъемов и с боков	Лак ХС Жирорастворимый судан III Колонковая кисть № 1 или № 2			
Сушка			18—25	120—180
Обезжиривание	Полировальная из- весть			
Промывка проточной горячей водой			45—50	0,5—1,0
Активация химическая	Соляная кислота	150—200		0,08
Промывка холодной проточной водой			18—25	1—2
Промывка в дистиллированной воде			18—25	1

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Серебрение печатных	Состав 1: азотнокислое серебро (в пересчете на металлическое) железосинеродистый калий углекислый калий роданистый калий	40—50 100—120 50—60 120—150	18—25	
	Состав 2: дицианоаргентат (в пересчете на металлическое серебро) роданистый калий углекислый калий	40—50 200—250 20—30		
Промывка в сборнике I	Вода дистиллированная		18—25	0,25—0,5
Промывка в сборнике II	Вода дистиллированная		18—25	0,25—0,5
Промывка в сборнике III	Вода дистиллированная		18—25	0,25—0,5
Сушка				
Контроль				

Примечания:

1. Скорость осаждения из роданистосинеродистого электролита серебрения при плотности тока $0,2 \text{ А/дм}^2$ — 10 мкм/ч

2. Скорость осаждения из дицианоаргентатного электролита при плотности тока 1 А/дм^2 — 1 мкм за 2 мин

ПАЛЛАДИРОВАНИЕ РАЗЪЕМОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Подготовка поверхности				
Палладирование	Двуххлористый палладий (в пересчете на металл) Аммоний хлористый Аммиак водный	18—25 15—20 2—5	20±5	
Промывка в сборнике I				0,3—0,6
Промывка в сборнике II				0,3—0,6
Промывка в сборнике III				0,3—0,6
Промывка проточной водопроводной водой				0,3—0,6
Промывка горячей водой				0,3—0,6
Контроль				

Примечания:

1. Скорость осаждения при плотности тока 1 А/дм² — 1 мкм за 4 мин. Значение рН электролита 8,5—9,5.

2. Аноды нерастворимые (из платинированного титана, графита или частично растворимые из палладия). Расход анодов составляет до 1,9% от расхода металлического палладия, идущего на покрытие деталей.

3. Допускается введение в электролит малеинового ангидрида в количестве до 0,15 г/л.

ЗОЛОЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Зачистка поверхности разъемов	Шлифшкурка № 6 или № 7			
Изолирование мест над контактными площадками	Изоляционная лента ПВХ 30×0,2			
Зачистка поверхности разъемов	Шлифпорошок № 11 или № 12			
Промывка проточной водой			18—25	0,5—1,0
Сушка			35—40	5—10
Покрытие лаком поверхности ниже печатных разъемов и с боков печатной платы	Лак ХСЛ Жирорастворимый судан III Колонковая кисть № 1 или № 2			
Сушка			18—25 или 60—80	960—1440 60
Обезжиривание	Полировальная известь			
Промывка проточной горячей водой			45—50	0,5—1

Продолжение

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Монтирование платы				
Активация химическая	Соляная кислота	150—200		0,08—0,16
Промывка в холодной проточной воде			18—25	1—2
Промывка в дистиллированной воде			18—25	1
Серебрение печатных разъемов				
Золочение ламалей				
Активация химическая	Соляная кислота	150—200		0,08—0,16
Промывка в холодной проточной воде			18—25	0,5
Промывка в дистиллированной воде			18—25	0,5
Золочение	Дицианоаурат калия (в пересчете на металлическое золото) Лимонная кислота Сернокислый кобальт (в пересчете на металлический кобальт)	9—10 60—80 1	30—35	12—15

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание, г/л	Температура, °С	Время, мин
Промывка в сборнике I				0,5
Промывка в сборнике II				0,5
Промывка в холодной проточной воде				
Сушка			35—40	5—10
Удаление лаковой пленки				
Протирание спиртом	Этиловый спирт Бязь			
100%-ный контроль качества по внешнему виду и толщине покрытия				
Удаление технологических проводников				
Нанесение слоя лака	Клей ХВК-2А			
Сушка			18—25	30
Нанесение второго слоя лака				
Сушка			18—25	15

Продолжение

Последовательность операций и переходов	Компоненты		Режимы	
	Наименование	Содержание г/л	Температура °С	Время, мин
Сушка			40—50	30
100%-ный контроль качества по внешнему виду и 1%-ный контроль по толщине покрытия				

Примечания.

1 Серебрение проводят в соответствии с приложением 9

2. Значение рН электролита золочения 4,5—5,5, аноды из платинированного титана, допускается применение анодов из стали марок 12Х18Н9Т, температура электролита 20—30°С, плотность тока 0,5—0,7 А/дм²; скорость осаждения 0,14—0,20 мкм/мин

3 Допускается перед основным процессом золочения наносить подслои золота толщиной 0,05—0,1 мкм из электролита состава

дицианоурат калия (в пересчете на металлическое золото) 1 г/л;

лимонная кислота 6,0—6,5 г/л;

цитрат калия 45—50 г/л;

сернокислый кобальт (в пересчете на металлический кобальт) 0,06—0,08 г/л.

рН электролита 6,2—7,0, катодная плотность тока 0,8—1,0 А/дм², анодная плотность тока 0,3—0,5 А/дм², температура электролита 24—30°С, продолжительность нанесения покрытия 0,5 мин.

ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОЛИТА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неполадок	Возможные причины	Способы устранения
Химическое осаждение меди		
Непокрытие отверстий печатных плат	Некачественная подготовка поверхности	Улучшают подготовку поверхности
	Не в норме растворы сенсибилизации и активации	Проверяют содержание двухвалентного олова и палладия в растворах сенсибилизации и активации
	Мала продолжительность обработки плат в растворах сенсибилизации, активации и химического меднения	Соблюдают режим обработки печатных плат в рабочих растворах
Темное покрытие	Разлагается раствор химического меднения	Отфильтровывают раствор в запасную емкость, добавляют стабилизатор
	Недостаток щелочи в растворе химического меднения	Корректируют раствор химического меднения
Разложение раствора химического меднения	Высокая плотность загрузки печатных плат в раствор химического меднения	Плотность загрузки должна составлять 2 дм ² /л
	Некачественная промывка печатных плат после активации	Тщательно промывают платы после активации
	Недостаточное количество стабилизатора в растворе химического меднения	Добавляют в раствор стабилизатор

Продолжение

Характер неполадок	Возможные причины	Способы устранения
Кислые электролиты меднения		
Грубая крупнокристаллическая структура осадков	Недостаток кислоты или избыток сернокислой меди	Корректируют состав электролита
Темные шероховатые осадки	Высокая плотность тока	Снижают плотность тока
Шероховатый осадок («наброс меди»)	Попадание закиси меди в осадок	Добавляют в электролит серную кислоту
Хрупкие осадки с темными пятнами	Загрязнение электролита механическими примесями	Отфильтровывают электролит
Светлые полосы на осадках	Недостаток серной кислоты	Добавляют кислоту
Пассивирование анодов (серый налет) в борфтористоводородном электролите	Высокая плотность тока	Снижают плотность тока
Пассивирование анодов (коричневый налет) в кремнефтористоводородном электролите	Загрязнение электролита органическими веществами	Прорабатывают электролит
Наличие игольчатых кристаллов на поверхности осадка	Недостаток борфтористоводородной кислоты	Добавляют борфтористоводородную кислоту
Наличие игольчатых кристаллов на поверхности осадка	Недостаток кремнефтористоводородной кислоты	Добавляют кремнефтористоводородную кислоту
Наличие игольчатых кристаллов на поверхности осадка	Присутствие органических примесей	Обработать электролит активным углем
Борфтористоводородный электролит для осаждения сплава олово-свинец		
Крупнокристаллическая структура осадка (образование дендритных наростов)	Пониженное содержание борфтористоводородной кислоты в электролите	Проводят анализ, добавляют борфтористоводородную кислоту
	Недостаток клея в электролите	Добавляют клей в электролит

Характер неполадок	Возможные причины	Способы устранения
Плохая рассеивающая способность ванны	Недостаток свободной борфтористоводородной кислоты	Проводят анализ и корректируют электролит
Полосчатость осадка	Избыток клея в электролите	Отфильтровывают осадок, разбавляют электролит водой и корректируют
Избыточное количество свинца в осадке	Избыточное количество свинца в электролите	Осаждают избыточное количество свинца серной кислотой в отдельной порции электролита, объем которой зависит от объема ванны и количества избыточного свинца в 1 л электролита. Отфильтровывают осадок и раствор присоединяют к основному электролиту
	Состав электролита в норме по свинцу, но количество клея недостаточно	Добавляют в электролит 1—2 г/л клея. Ввиду того, что клей со временем коагулирует, необходимо вводить его периодически (раз в 15—20 дней)
	Недостаточное количество олова в электролите	<p>Вводят недостающее количество олова в электролит</p> <p>При небольшом количестве недостающего олова вводят олово путем проработки электролита с добавочными оловянными анодами (2—4 анода на ванну) до получения нужного состава осадка по олову</p> <p>При большом количестве недостающего олова вводят его в электролит через углекислую медь, которая вытесняется из раствора порошкообразным оловом</p>

Продолжение

Характер неполадок	Возможные причины	Способы устранения
Кислый электролит никелирования		
<p>Покрытие имеет желтый оттенок, на кромках плат возможно образование зеленых гидратов окиси никеля</p>	<p>Высокое значение рН (щелочной электролит)</p> <hr/> <p>Чрезмерно высокая катодная плотность тока</p> <hr/> <p>Недостаток фтористых солей</p>	<p>Проверяют рН и подкисляют электролит 3%-ным раствором серной кислоты</p> <hr/> <p>Снижают плотность тока</p> <hr/> <p>Добавляют фториды до нормы</p>
<p>Никель имеет нормальный оттенок, но отслаивается</p>	<p>Плохая подготовка перед покрытием</p> <hr/> <p>Перерыв тока или изменение плотности тока</p>	<p>Улучшают подготовку поверхности</p> <hr/> <p>Устраняют возможность перерыва тока</p>
<p>Слой никеля блестящий с продольными трещинами</p>	<p>Накопление в электролите солей железа более 0,11 г/л</p>	<p>Подкисляют электролит до рН-3, вводят перекись водорода, нагревают и перемешивают, защелачивают до рН-6 и отфильтровывают</p>
<p>Отслаивание никеля в виде мелких блестящих чешуек, легко осыпающихся от прикосновения</p>	<p>Слишком кислый электролит и высокая плотность тока</p> <hr/> <p>Низкая концентрация серноокислого никеля при большом содержании проводящих солей</p>	<p>Подщелачивают электролит и снижают плотность тока</p> <hr/> <p>Добавляют серноокислый никель</p>
<p>Водородная пористость на покрытии (питтинг)</p>	<p>Загрязнение органическими примесями и солями железа</p>	<p>Подкисляют электролит, вводят 5 мл 3% ного раствора перекиси водорода на 1 л электролита, затем электролит нагревают и перемешивают, доводят до рН-6 и отфильтровывают</p>

Характер неполадок	Возможные причины	Способы устранения
Электролиты серебрения		
<p>Аноды покрываются серым налетом, выпадающим в шлам (анодное пассивирование). Осадок темный, рыхлый или шероховатый</p>	Высокая анодная плотность тока	Понижают анодную плотность тока
	Низкое содержание роданидов	Увеличивают содержание роданидов
	Обеднение электролита серебром	Корректируют электролит
	Повышенная плотность тока	Понижают плотность тока
Интенсивное растворение анодов	Высокое содержание роданидов	Корректируют электролит
Кислый электролит золочения		
Покрытие темное, рыхлое	Высокая плотность тока	Снижают плотность тока
Красный оттенок покрытия	Примеси солей меди в электролите	Прорабатывают электролит
Беловатый или зеленоватый оттенок покрытия	Примеси серебряных солей в электролите	Прорабатывают электролит
Бледный тон покрытия	Низкая плотность тока	Повышают плотность тока
	Низкая концентрация золота в электролите	Доводят до нормы содержание золота в электролите
	Низкая температура электролита	Повышают температуру

Характер неполадок	Возможные причины	Способы устранения
<p>Покрытие хрупкое, шелушение и отслаивание</p>	<p>Наличие примесей ионов меди или железа в электролите, загрязнение органическими примесями, плохая подготовка поверхности перед нанесением покрытия, содержание ионов хлора свыше 150 г/л</p>	<p>Производят регенерацию электролита, проверяют и корректируют режимы работы и подготовки поверхности, отфильтровывают электролит через активированный уголь</p>
<p>Покрытие темное со светлыми пятнами или полосами</p>	<p>Мало расстояние между электродами и платами</p>	<p>Увеличивают расстояние между электродами и платами</p>
<p>На анодах желтая соль диаминохлорида палладия</p>	<p>Недостаток в электролите аммиака, большая анодная плотность тока или низкое значение рН электролита</p>	<p>Корректируют электролит по содержанию аммиака, увеличивают площадь анодов, корректируют значение рН электролита</p>
<p>Раствор окрашен в синевато-зеленый цвет</p>	<p>Наличие примеси меди в электролите</p>	<p>Производят регенерацию электролита</p>
<p>На покрытии кристаллическая сетка</p>	<p>Большая объемная плотность тока</p>	<p>Уменьшают площадь загрузки</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

1 Оборудование, применяемое для гидроабразивной зачистки заготовок печатных плат, должно соответствовать требованиям ГОСТ 23664—79

2 Установка для приготовления смеси кислот должна быть снабжена устройством для перемешивания смеси кислот и системой охлаждения кислот

3 Операция подтравливания диэлектрика в смеси кислот (концентрированных) должна выполняться в специальной установке

Установка должна быть снабжена устройством для перемещения заготовок плат в плоскости, обеспечивающей интенсивное прохождение раствора через отверстия в заготовках

Установка должна быть оснащена системой нагревания и термостатирования рабочего раствора и насосом для перекачки

4 Оборудование, применяемое для выполнения операции сенсibilизации и активации, должно обеспечивать прохождение рабочих растворов через отверстия в заготовках печатных плат

Рабочие емкости должны быть снабжены плотно закрывающимися крышками

5 Оборудование, применяемое для химического меднения печатных плат, должно обеспечивать нагревание рабочего раствора до 60°C, прохождение рабочих растворов через отверстия в заготовках печатных плат непрерывную или периодическую фильтрацию рабочих растворов. Скорость фильтрации должна обеспечивать 3—5 кратный обмен раствора в течение часа

При химическом меднении заготовок печатных плат, кроме основной емкости для рабочего раствора, должна быть предусмотрена дополнительная емкость, в которую переливают рабочий раствор после окончания работы

6 При выполнении гальванической металлизации ванны должны быть снабжены системами обеспечивающими интенсивное прокачивание электролитов через отверстия в заготовках печатных плат

7 Расстояние между катодной и анодной штангами должно быть не менее 150 мм

8 Ванна для гальванического меднения должна быть снабжена системой фильтрации

Редактор *В С Закирова*

Технический редактор *Э В Митяи*

Корректор *Г И Чуйко*

Сдано в наб 28 03 88 Подп в печ 13 05 88 25 усл п л 2 625 усл кр отт 2 42 уч изд 1
Тираж 10 000 Цена 10 коп

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов 123840 Москва 1СП
Новопресненский пер 14

Вильнюсская типография Издательства стандартов ул 4 рясчя 1989 34к 1154

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражена через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	s^{-1}
Сила	ньютон	N	Н	$м \cdot кг \cdot с^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$с \cdot А$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^4 \cdot А^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^3 \cdot А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$м^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$с^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$м^2 \cdot с^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$м^2 \cdot с^{-2}$